

江苏亨通光电股份有限公司

关于对外投资的补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2018年3月19日，公司公告了与安徽传矽微电子有限公司（以下简称“安徽传矽”）共同合作设立江苏科大亨芯半导体技术有限公司（公司名称最终以工商登记为准，以下简称“科大亨芯”或“合资公司”）事宜。详见上海证券交易所网站，公告编号：2018-014号。现就无形资产出资事项补充公告如下：

1. 科大亨芯注册资本10,000万元，其中，亨通光电以货币出资7,000万元，占注册资本的70%；首期出资2,000万元，在公司成立后10个工作日内缴付；二期出资5,000万元，由董事会根据项目进度及经营需要确定缴付时间。

安徽传矽以知识产权方式出资，将其拥有的专利及非专利技术评估作价3,000万元，占注册资本的30%。专利及非专利技术包括：

- 1) “2.4GHz ISM Band低功耗低噪声射频前端”等16项芯片IP核类技术成果（非专利技术），技术成果所有人：安徽传矽微电子有限公司；
- 2) “一种增益可调的射频接收前端电路”等45项发明专利（其中21项已授权），专利权人：中国科学技术大学。

上述作为知识产权出资的专利及非专利技术，不存在抵押、质押的情况，也不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、查封或冻结等司法措施。

2. 安徽传矽应在合资公司成立之日起六个月内完成移交相关知识产权信息资料的手续，需要取得专利权作为工商登记出资的，将在合资公司成立后一个月內着手进行取得专利的手续，并在合资公司成立3年内完成专利评估作价和转让手续。安徽传矽将按照有关规定的审批程序，通过合法、合规方式将相关知识产权权利转入合资公司。

3. 安徽传矽以无形资产出资，应当评估作价并依法办理其财产权的转移手续，具体情况届时以评估结果为准。

风险提示：

1. 知识产权评估程序在合资公司成立后开展，可能存在评估值达不到3,000万元的风险。
2. 安徽传矽可能存在不能按时将上述发明专利转入合资公司的风险。

特此公告。

江苏亨通光电股份有限公司

董事会

二〇一八年三月二十二日